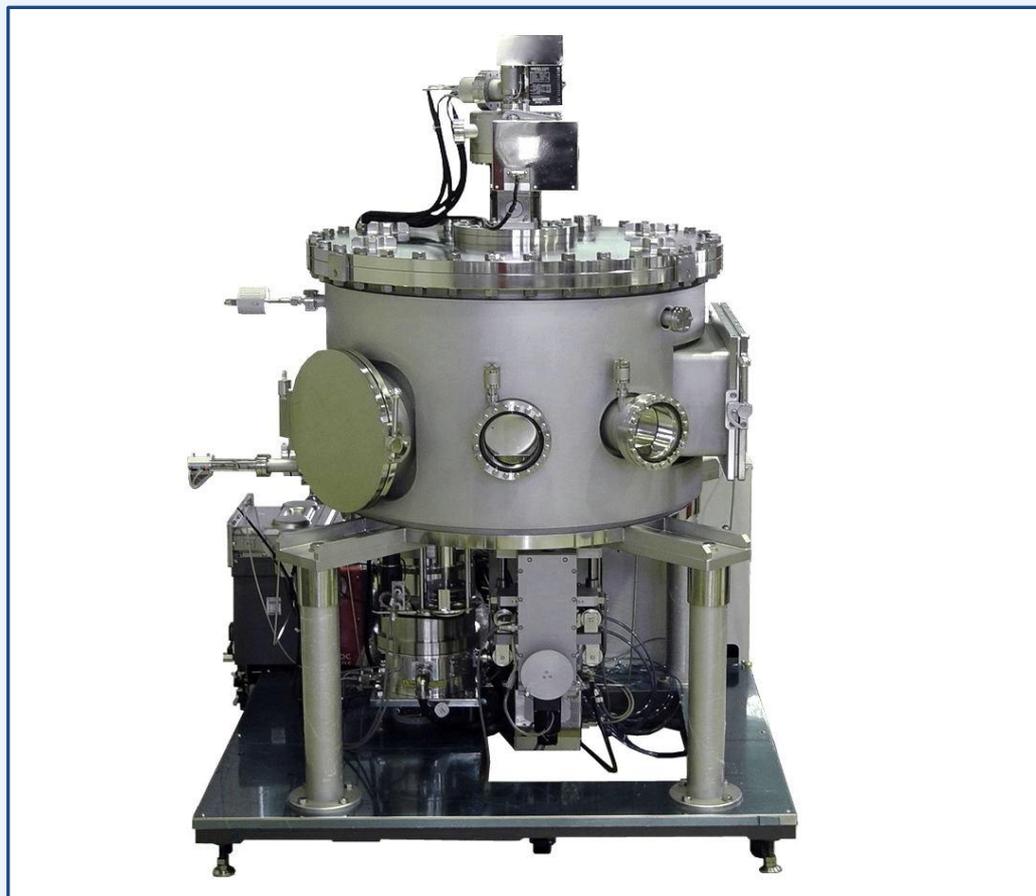


スパッタリング装置

ES-830



■概要■

本システムは、300mm×400mmの大面積用スパッタリング装置です。
8インチのスパッタ源による、3元のスパッタリングが可能です。
ターゲット、基板間の間隔は連続して可変調整できます。

■仕様■

<スパッタ室>

到達圧力 10^{-5} Pa台

基板寸法 300mm×400mm

基板加熱温度 Max 700°C

排気系 TMP+RP

オプション 成膜ソフト

<スパッタ源>

ターゲット寸法 φ8インチ

ターゲット数 3基

RF電源 3kW (オートマッチャー付)